

# The Partner for Success

## 第50期 中間ビジネスレポート

2025年4月1日～2025年9月30日

株式会社 図研

証券コード 6947

製造業の未来を支える技術とソリューションで、  
お客さまの価値創造に貢献してまいります

株主の皆さまには、平素のご厚情に心より御礼申し上げます。第50期中間ビジネス  
レポートをお届けするにあたり、業績および事業活動に関してご報告いたします。

代表取締役社長 勝部 孔也



業績について

当中間期の経済環境につきましては、米国通商政策の影響  
が見通せないことなどから先行きの不透明感は続いている  
ものの、全体としては緩やかな回復基調で推移しました。製造  
業におけるDXへの取り組みは継続しており、当社グループ  
の主要なお客さまであるエレクトロニクス製造業、自動車関  
連・産業機器製造業におきまして、DXに向けたIT投資は  
活発な状況が続いています。

このような中で、当中間期の売上高は、194億5千4百万

円（前年同期比 2.0 % 増）となり、過去最高を更新いたしま  
した。これは、主力の電気設計システム「CR-8000 Design  
Force」の売上が日本において大きく伸長したことや、データ  
管理システムDSシリーズの売上が欧州を中心に堅調に推移  
したことなどによるものです。

利益面につきましては、将来に向けた開発投資により経費  
が増加したものの、売上高が伸びたことなどから、営業利益  
23億7千1百万円（前年同期比 2.1 % 増）、経常利益29億5千  
8百万円（前年同期比 19.1 % 増）、親会社株主に帰属する中間

純利益20億9千5百万円（前年同期比 28.7 % 増）と、いずれも  
過去最高を更新しました。

第50期（2026年3月期）中間期業績（）は前年同期比		
売上高	194億5千4百万円	（2.0 % 増）
経常利益	29億5千8百万円	（19.1 % 増）
親会社株主に帰属する中間純利益	20億9千5百万円	（28.7 % 増）

株主還元策について

当社は、来たる2026年12月17日をもちまして創立50周  
年を迎えます。これもひとえに株主の皆さまをはじめ、関係各  
位のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

つきましては、株主の皆さまに感謝の意を表するため、  
2026年3月期の期末配当金につきましては、1株当たり100円  
の創立50周年記念配当の実施を予定しております。これによ  
り、期末配当金は普通配当50円を含めまして1株につき150円  
に、中間配当金（1株につき50円）を含めた年間配当金は、1株  
につき200円とさせていただきます。

なお、自己株式の取得につきましても、当期中に30億円、  
75万株を上限として実施しています。

今後の取り組みについて

昨今の急速な技術革新は、モノづくり環境に大きな影響を  
与えています。特にAI技術の進化は、次世代半導体など、先端  
エレクトロニクス技術の開発を加速させるとともに、製品開  
発プロセスにも変化をもたらしています。

モノづくり企業は、製品のシステム要件が複雑化・高度化  
する中、効率的に最適解を導くため、構想設計のデジタル化  
を起点とした設計・製造プロセス全体のDXへの取り組みを  
進めています。

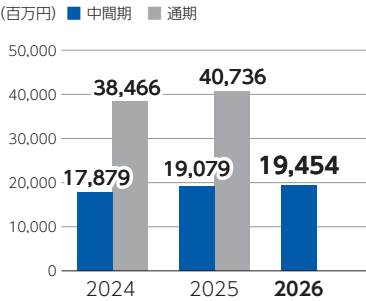
当社は、こうした市場動向とお客さまのニーズを的確に捉  
え、次世代半導体の先端パッケージング技術の設計開発支援  
を強化するとともに、MBSE<sup>\*</sup>を中核としたソリューションの提  
案に積極的に取り組んでまいります。そして、国内外の市場に  
おいて、お客さまの価値創造に一層貢献してまいります。

株主の皆さまには、引き続きご理解とご支援を賜りますよ  
うお願い申し上げます。

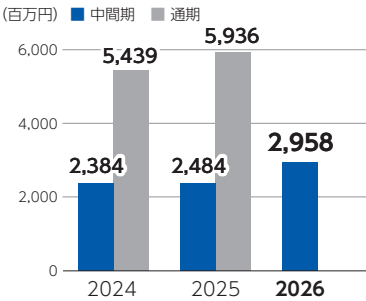
<sup>\*</sup>MBSE（モデルベース・システムズエンジニアリング）：複雑な製品やシステムの開発において、仕様や  
要件、設計情報をデジタルモデルで可視化・一元管理し、開発の効率化と品質向上を図る手法

連結財務ハイライト

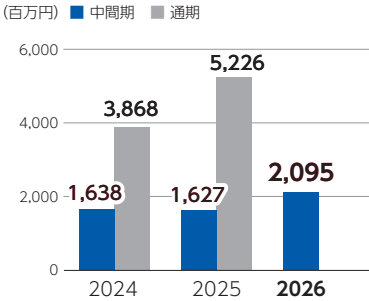
売上高



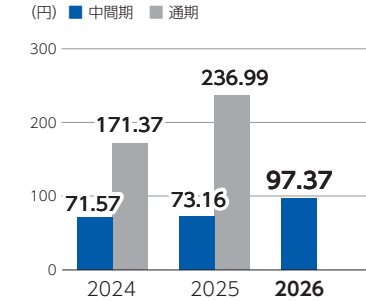
経常利益



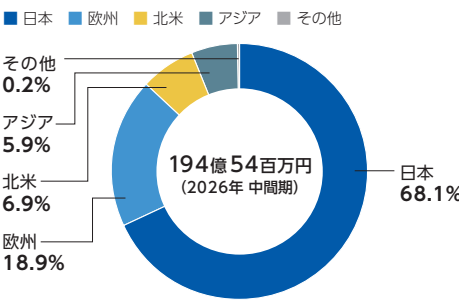
親会社株主に帰属する中間 (当期) 純利益



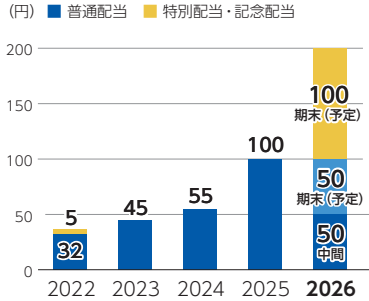
1株当たり中間 (当期) 純利益



地域別売上高



配当金の推移



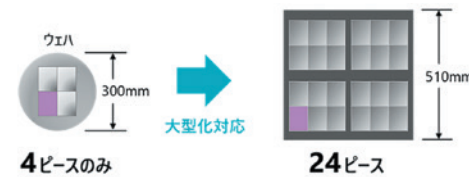
## 次世代半導体パッケージのコンソーシアム「JOINT3」に参画

図研は、株式会社レゾナックにより設立された次世代半導体パッケージの共創型コンソーシアム「JOINT3」に参画しました。

JOINT3は、半導体の材料・装置・設計の各分野において世界トップクラスの企業27社が集結し、パネルレベル有機インターポザーに適した材料・装置・設計ツールの開発を加速することを目的としています。

昨今、市場が急拡大している生成AIや自動運転を実現する次世代半導体においては、後工程のパッケージング技術がキーテクノロジーのひとつとなっています。なかでも複数の半導体チップを並列に配置し、インターポザー（中間基板）を介して接続し、実装した2.xDパッケージの需要拡大が見込まれています。インターポザーは、半導体の性能向上に伴いそのサイズが大型化し、シリコンインターポザーから有機材料を用いた有機インターポザーへの移行が進んでいます。これにより、インターポザーの製造プロセスにおいて、従来の円形ウェハ

から大型の四角いパネル形状に変更し、インターポザーの取り数を増加させることが可能になります。

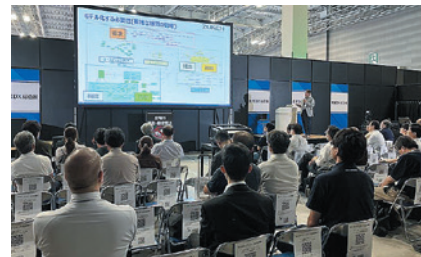


当社は、長年にわたり先端パッケージ設計環境を提供してきた実績と知見を活かし、JOINT3においてパネルレベル有機インターポザーによる次世代半導体パッケージング設計・製造の実践と評価に取り組む予定です。さらには、参画企業との共創により、次世代半導体パッケージの設計・製造・評価プロセスの進化に貢献し、次世代のエコシステムやサプライチェーンの一翼を担うことを目指します。

## MBSE新ソリューション「SIDEKICK」をリリース 製品開発におけるWebコラボレーションを促進

当社は、MBSEによる製品開発コラボレーションを支援する新ソリューション「SIDEKICK」を発表しました。本製品はMBSEモデリングツール「GENESYS」と連携し、システム設計プロセスにおいてWeb上でシステムモデルを共有・レビューできる環境を提供します。これにより、設計者間だけでなく、顧客を含む関係者間の情報共有や意思決定を効率化し、製品開発プロセスを変革します。

当社は、「製造業DX EXPO 2025 夏 東京」(7月30日～8月1日)や「オートモーティブワールド2025 秋」(9月17日～19日)において講演やブース展示を行い、製造業DX支援として、MBSEソリューションをご紹介しました。



「製造業DX EXPO 2025 夏 東京」の特別講演において、専務執行役員 上野泰生がMBSEソリューションを紹介

### ZIW / ZdSレポート

## 「Zuken Innovation World / ZUKEN digital SESSIONS 2025」を開催 リアルとオンラインで広がるお客さまへの情報発信と交流



2025年10月16日・17日に、当社が世界各国で開催しているプレミアムイベント「Zuken Innovation World (ZIW)」を横浜で開催しました。本イベントでは、当社の事業・技術ビジョンの発表をはじめ、お客さまによる製品導入事例、半導体関連企業やアカデミアによる次世代パッケージング技術のトレンド講演など、多彩なプログラムを提供しました。

また、会場では、当社製品の操作体験会やブース展示を実施し、当社エンジニアが最新機能や操作方法について、デモを交えて直接ご説明しました。講演終了後の懇親パーティにも多くのご参加をいただき、盛況のうちに終了しました。

さらに、ZIWの翌週の10月20日から11月13日まで、オンラインイベント「ZUKEN digital SESSIONS (ZdS)」を開催。当社主力製品の開発ロードマップや新ソリューション企画の発表、パートナー企業の最新ソリューション紹介などをオンデマンドで配信しました。ZdSは、横浜で開催したZIWにご参加いただけなかったお客さまにも、当社ビジョン講演やお客さま事例講演のオンデマンド配信をご視聴いただける機会を提供し、毎年大変ご好評をいただいています。



懇親パーティで挨拶する勝部社長



図研ビジョン講演の様子



製品操作体験会の様子

### Zuken Innovation World

開催日程：2025年10月16日・17日

会場：横浜ベイホテル東急

#### 講演プログラム

<国内企業>

アイシン、カシオ計算機、キヤノン、コルグ、東京エレクトロン宮城、日本アイ・ビー・エム、ヒラノテクシード、レゾナック ほか 計19講演

<海外企業>

Grand Large Yachting、Microsoft Corporation、Metrohm AG 計3講演

### ZUKEN digital SESSIONS

開催期間：2025年10月20日～11月13日

会場：オンライン

#### 主なプログラム

- ・図研 製品開発ロードマップ …… 11セッション
- ・図研 新ソリューション企画 …… 6セッション
- ・技術パートナー、図研グループ講演 9セッション
- その他、ZIW講演の一部をオンデマンド配信



## 図研プリサイト

### 設計・製造ソリューション展に出展 設計と製造をつなぐPLMソリューション [Visual BOM]を紹介

図研プリサイトは、2025年7月9日～11日に幕張メッセで開催された「設計・製造ソリューション展 [東京]」に出展しました。ブースでは、設計成果物である図面とBOM（部品表）に超軽量3Dデータ(XVL※)を統合するPLMソリューション[Visual BOM]のプレゼンテーションおよびデモを実施。設計から製造間の情報共有を高度化し、開発プロセスの効率化を実現するソリューションとして紹介しました。会期中は多くのお客さまにご来場いただき、盛況のうちに終了しました。

※XVLは、ラティス・テクノロジー株式会社の登録商標です



図研プリサイトブース

## 図研ネットウェイブ

### 自己学習型AI搭載のセキュリティ製品の プロモーションを強化

セキュリティソリューションやストレージなどのネットワーク製品を販売する図研ネットウェイブは、自己学習AIを活用したセキュリティプラットフォーム[Darktrace]のプロモーションを強化しています。2025年10月に、「今、製造業に求められるセキュリティとは何か?」と題し、ダークトレース・ジャパンとの協賛によるセミナーを開催。「止めないセキュリティ」をテーマに、製造業向けの先進的なセキュリティ対策を提案しました。また、当社情報誌『fromZ』第35号では、「AI時代のサイバー攻撃への備え」をテーマに、両社の社長による対談記事を掲載しています。



ダークトレース・ジャパン代表 田井社長  
図研ネットウェイブ代表 伊藤社長  
fromZ 対談記事



## 図研海外拠点

### 欧州5カ国で「Zuken Innovation World 2025」を開催

図研の欧州拠点では、2025年6月から9月にかけて、スイス、ドイツ、イギリス、フランス、イタリアの5カ国で「Zuken Innovation World (ZIW) Europe 2025」を開催しました。各会場には製造業・エレクトロニクス業界のエンジニアやパートナーが集い、当社製品「CR-8000」[E3.series]「DS-2」を活用したお客さま事例の紹介や、「GENESYS」によるMBSEの取り組みを紹介する講演が行われました。さらに、スマートマニュファクチャリングや次世代モビリティなど、最新の製品・ソリューションも展示され、お客さまやパートナー企業との活発な交流が行われました。欧州各拠点では、ZIW開催を通じてパートナーシップの強化と新たなビジネス展開につなげています。

図研では、「エンジニアリングITによる持続可能なモノづくりへの貢献」をサステナビリティの重要課題の一つとし、ソフトウェア事業の源泉である人的資本の拡充、モノづくり業界への貢献を目的とした次世代エンジニア育成に積極的に取り組んでいます。



図研のWebサイトに、サステナビリティ関連の情報を掲載しています

### 学生フォーミュラ2025に協賛

当社は、2019年から学生フォーミュラ日本大会に協賛し、同大会に出場する地元の横浜国立大学フォーミュラチームも支援しています。同チームは、2025年9月8日～13日に、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催された「学生フォーミュラ日本大会2025」に出場。全種目完走を達成し、EVクラスで総合7位という成績を収めました。



横浜国立大学のフォーミュラカー

当社は、同チームへワイヤハーネス設計システム[E3.series]を提供し、電気設計環境の構築をサポートしています。

### 模擬人工衛星の打ち上げ競技会「ARLISS」に協賛

当社は、大学宇宙工学コンソーシアム(UNISEC)の活動に賛同し、2023年から企業会員として参画しています。UNISECが米国のアマチュアロケット団体「AERO-PAC」と共催する国際宇宙教育プログラム「ARLISS」は、学生が自作の模擬衛星「CanSat」を用い、ロケットからの放出・誘導・帰還を競う実践型学習の場です。当社は、9月に米国



今年開催されたARLISSの様子 (米国ネバダ州)

で開催されたARLISSへの協賛、また参加チームへのMBSEツール「GENESYS」の提供を通じて、次世代エンジニアの活動を支援しています。



ZIW Germanyの講演会場



ZIW Germanyのネットワーキング



ZIW Franceのネットワーキング

## 会社情報 (2025年9月30日現在)

社名 株式会社図研 ZUKEN Inc.  
設立 1976 (昭和51) 年12月17日  
資本金 101億1,706万5千円  
株式市場 東京証券取引所プライム市場  
従業員数 453名 連結1,644名  
URL <https://www.zuken.co.jp/>

## 取締役・監査役

代表取締役会長 金子 真人  
代表取締役社長 勝部 迅也  
代表取締役副社長 相馬 肅一  
取締役\* 佐野 高志  
取締役\* 高原 わかな  
監査役(常勤) 和田 扶佐夫  
監査役\* 高田 保豊  
監査役\* 川口 恵都子

※は社外取締役および社外監査役です。

## 執行役員

専務執行役員 飯屋 和浩  
専務執行役員 上野 泰生  
執行役員 藤原 宏行  
執行役員 大澤 岳夫  
執行役員 早乙女 幸一  
執行役員 奈良 功  
執行役員 大塚 隆夫

## 株主メモ

事業年度 4月1日から翌3月31日まで  
定時株主総会 毎年6月  
基準日 定時株主総会の議決権 3月31日  
期末配当 3月31日  
中間配当 9月30日  
公告方法 電子公告  
(当社Webサイト  
<https://www.zuken.co.jp/e-koukoku/>)  
なお、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。  
株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社  
および口座管理機関  
同連絡先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号  
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
☎0120-232-711

## 図研Webサイトのご案内

### コーポレートサイト



ニュース & トピックス



### 投資家情報 (IRサイト)



## 住所変更、単元未満株式の買取のお申出先について

口座をお持ちの証券会社にお申出ください。なお、特別口座で株式が管理されている株主の方は、口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社にお申出ください。

## 未払配当金の支払いについて

株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社にお申出ください。

## 株式会社 図研



本社・中央研究所 〒224-8585 横浜市都筑区荏田東2-25-1  
センター南ビル 〒224-8580 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-11  
新横浜ビル 〒222-8505 横浜市港北区新横浜3-1-1  
関西支社 〒530-0004 大阪市北区堂島浜2-2-28 堂島アクシスビル  
名古屋支社 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-23-20 HF桜通ビルディング

TEL: 045-942-1511(代)  
TEL: 045-942-1300(代)  
TEL: 045-473-6868(代)  
TEL: 06-6343-1141(代)  
TEL: 052-950-3671(代)



この報告書は、環境に優しい植物油系インキを使用しています。